

第 38 回 電子デバイス実装研究委員会

日時：2022 年 7 月 11 日（月）13:00～16:05

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 櫻井 大輔（パナソニック HD 株式会社）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『フェーズフィールド・クリスタル法による加圧ボンディングプロセスのシミュレーション』（40 分）
.....○篠嶋 妥, 小野澤 亮祐, 畠山 慎悟, 岩本 知広（茨城大学）

13:50～14:30

『Zn/Ag 固相拡散接合のダイボンドへの適用検討』（40 分）
.....○山崎 浩次, 上山 椋平（三菱電機株式会社）

14:30～14:45 休 憩

司会 山内 啓（群馬工業高等専門学校）

14:45～15:25

『電子機器実装を支える高機能樹脂材料』（40 分）
.....○伊達 仁昭（日邦産業株式会社）

15:25～16:05

『最近のリフロー方法の特徴とはんだ材料について』（40 分）
.....○萩尾 浩一（株式会社ニホンゲンマ）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。
※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会